

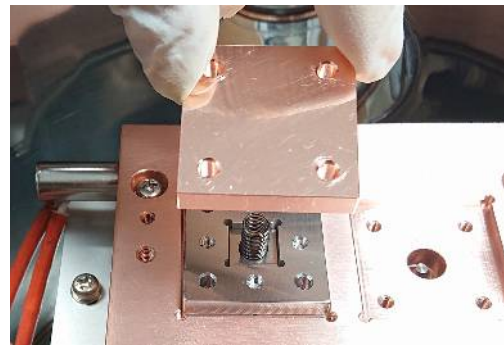
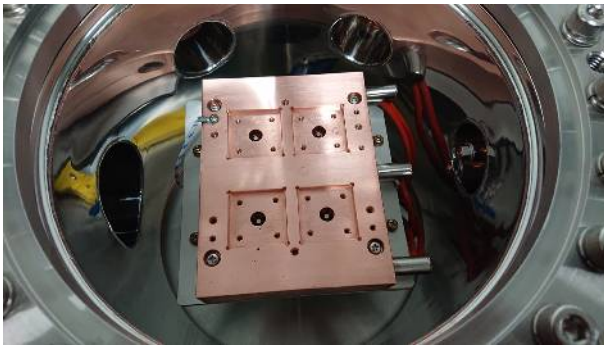
MEMSの真空パッケージング

卓上真空接合装置



- MEMSパッケージの卓上真空接合装置
- 真空加熱治具とリフター機構をコンパクトに搭載
- ダイアフラムポンプとターボ分子ポンプのセットで完全ドライ
- 到達真空度: 1E-6hPa (1E-4Pa) 以下
- フルレンジゲージを標準装備
- ワンタッチスイッチで簡単操作
- 電源電圧: AC100V (単相AC200V対応可)
- 最大消費電力: 300W、待機電力10W以下

- 真空加熱治具: 最高加熱温度300℃、400℃、500℃等 個別設計の特注対応



- リフター機構 下降時



- 上昇時



- 装置全体の設置スペース: 650(W)×400(D)×360(H) 総重量=約50Kg
- 参考価格帯(税別): 1式、¥4,500,000~¥5,500,000